# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-312854

(43) Date of publication of application: 09.11.1999

(51)IntCl.

H05K 1/14

H01R 9/09 H01R 23/68

(21)Application number: 10-119021

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

28.04.1998

(72)Inventor: UZUKA YOSHINORI

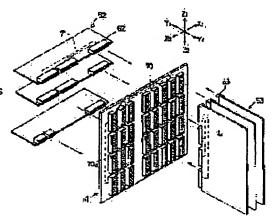
HANADA KOJI

#### (54) STRUCTURE FOR MOUNTING PRINTED WIRING BOARD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To lighten the load on back panel and process signals at a high speed.

SOLUTION: This structure comprises a back panel 51, a plurality of rear-side printed wiring boards 52, which are mounted to the rear of the back panel 51 by means of connectors, and a plurality of front-side printed wiring boards 53 which are inserted into a shelf from the front side and are connected with the back panel 51 by means of connectors. The front-side printed wiring board unit 53 is arranged in a direction of X1-X2 in an attitude in which it is in the vertical plane as a Y-X plane. It is vertical and the rear-side printed wiring boards 52 are horizontal, and both cross each other orthogonally. The rear-side printed wiring boards 52 are provided with wiring patterns 71, and they are plurally arranged in a direction of Z1-Z2 in an attitude, where they are in the horizontal plane as an X-Y plane. As a result, wiring patterns exceeding the maximum number of wiring patterns that can be provided by the back panel 51 itself are provided.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

24.10.2000

[Date of sending the examiner's decision of

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3698233

[Date of registration]

15.07.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出廢公開番号

# 特開平11-312854

(43)公開日 平成11年(1999)11月9日

(51) Int CL*		識別記号	FΙ		
H05K	1/14		H05K	1/14	H
H01R	9/09		H01R	9/09	E
	23/68	303		23/68	303G

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 14 頁)

		E4	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(21)出願番号	特顏平10-119021	(71)出顧人	000005223 富士通株式会社
(22)出願日	平成10年(1998) 4月28日		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号
		(72) 発明者	雜學 良典 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内
		(72)発明者	花田 浩二 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内
		(74)代理人	弁理士 伊東 忠彦
		1	

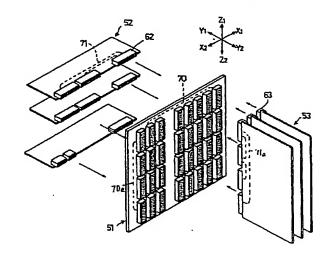
## (54) 【発明の名称】 プリント配線板実装構造

## (57)【要約】 (修正有)

【課題】 バックパネルの負担の軽減及び信号処理の高速化を実現する。

【解決手段】 バックバネル51と、バックバネル51の背面にコネクタ接続されて実装してある複数の背面側プリント配線板52と、前側からシェルフ内に挿入さる複数の前面側プリント配線板53とよりなる。前面側プリント配線板2コート53は、Y-X面である垂直面向に位置する姿勢で、X1-X2方向に並んでいる。前面側プリント配線板ユニット53は垂直、背面側プリント配線板52は水平であり、前面側プリント配線板52は水平であり、前面側プリント配線板52は、配線バターント53と背面側プリント配線板52は、配線バターント53と背面側プリント配線板52は、配線バターント53と背面側プリント配線板52は、配線バターント1~Z2方向に複数並んでおり、バックバネル51自身でまかなうことが可能である配線バターンの数を越える配線バターンをまかなう。

#### 図4(A)のプリングの発生実を構造の分析的提回



#### 【特許請求の範囲】

[請求項1] 前面に前面側コネクタを有し背面に背面 側コネクタを有するバックパネルに対して、複数の前面 側ブリント配線板がその端部のコネクタを上記前面側コ ネクタと接続させて実装してあり、且つ複数の背面側ブ リント配線板がその端部のコネクタを上記背面側コネク タと接続させて実装してある構成のブリント配線板実装 構造において、

前面側から見て、該前面側コネクタと該背面側コネクタ とは直交する関係にあり、該前面側プリント配線板と該 10 背面側プリント配線板とが直交する関係にある構成とし たことを特徴とするプリント配線板実装構造。

【請求項2】 上記バックパネルは、前面側に突き出た 複数の前面側ピンと背面側に突き出た複数の背面側ピン とを有し、

該背面側ピンは上記前面側ピンの一部のピンと電気的に 接続してあり、該背面側ピンとてれらと電気的に接続さ れて前面側に突き出た前面側ピンとが共通ピンを構成し ており、

上記背面側コネクタは、上記共通ピンのみを有する構造 20 であり、

上記前面側コネクタは、上記共通ピンを含んで上記前面 側ピンを有する構造であることを特徴とする請求項1記 截のプリント配線板実装構造。

【請求項3】 上記前面側ピン、背面側ピン及び共通ビ ンは、上記バックパネルのスルーホールを貫通している プレスフィットピンであることを特徴とする請求項2記 載のプリント配線板実装構造。

[請求項4] 上記前面側ピンは、上記バックパネルの スルーホールを貫通孔に、該バックパネルの前面側から 30 該バックパネルの厚さの約半分に相当する長さ圧入され ている構造であり、

上記共通ピンは、上記バックパネルのスルーホールの同 じ貫通孔に、該バックパネルの前面側から該バックパネ ルの厚さの約半分に相当する長さ圧入されているピン と、該バックパネルの背面側から該バックパネルの厚さ の約半分に相当する長さ圧入されているピンとよりなる 構成としたことを特徴とする請求項2記載のプリント配 線板実装構造。

前面のパッドに半田付けされて固定してあるピンであ り、

上記背面側ピンは、上記バックパネルの背面のバッドに 半田付けされて固定してあるピンであり、

上記共通ピンは、上記バックパネル内のピアと、該ピア と電気的に接続されて上記バックパネルの背面のパッド に半田付けされて固定してあるピンと、該ビアと電気的 に接続されて上記バックパネルのの前面のパッドに半田 付けされて固定してあるピンとよりなる構成としたこと を特徴とする請求項2記載のプリント配線板実装構造。

「請求項6】 上記背面側プリント配線板は、その端部 のコネクタ間をつなぐ配線パターンを有する構成とした ことを特徴とする請求項 1 記載のプリント配線板実装構

【請求項7】 上記背面側プリント配線板は、信号処理 を行う複数の素子が実装してあり、互いの素子間をつな ぐ配線バターン及び該素子と該背面側プリント配線板の 端部のコネクタ間をつなぐ配線パターンとを有する構成 としたことを特徴とする請求項1記載のブリント配線板 実装構造。

【請求項8】 上記バックパネルは、前面側から見て、 上記前面側コネクタと背面側コネクタとが交差する箇所 の近傍の部位に、信号処理を行う素子が実装してある構 . 成としたことを特徴とする請求項1記載のプリント配線 板実装構造。

【請求項9】 請求項7又は請求項8記載のプリント配 線板実装構造を備えてなる構成としたことを特徴とする サーバ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はブリント配線板実装 構造に係り、特に通信装置、情報処理装置等の一部を構 成するブリント配線板実装構造であってバックパネルに 複数のブリント配線板が並んで実装された構成のブリン ト配線板実装構造に関する。

[0002]

【従来の技術】図1(A), (B)は、通信装置のシェ ルフ (図示せず) 内に組み込まれている従来のプリント 配線板実装構造10を示す。11はバックパネルであ り、多層配線構造を有する。12は複数のプリント配線 板ユニットであり、プリント配線板13上にLSI14 等が実装してあり、コネクタ接続されて、バックパネル 11の前面11a側に垂直の向きで並んで実装してあ る。複数のプリント配線板ユニット12の間は、バック パネル11内の配線パターンによって電気的に接続され ている。

[0003]図2(A). (B)は、情報処理装置のシ ェルフ (図示せず) 内に組み込まれている従来のプリン ト配線板実装構造20を示す。プリント配線板実装構造 【請求項5】 上記前面側ビンは、上記バックパネルの 40 20は、情報の処理を行う。21はバックパネルであ り、多層配線構造を有する。22は複数の前面側プリン ト配線板ユニットであり、バックパネル21の前面21 a側にコネクタ接続されて垂直の向きで並んで実装して ある。30は複数の背面側プリント配線板ユニットであ り、バックパネル21の裏面21b側にコネクタ接続さ れて垂直の向きで並んで実装してある。前面側プリント 配線板ユニット22及び背面側プリント配線板ユニット 30は、夫々、プリント配線板23、31にLSI2 4、32が実装してある構造である。LSI24、32

50 は、ドライバとレシーバとを備えており、情報の処理を

行う。複数の前面側ブリント配線板ユニット22の間、 複数の背面側ブリント配線板ユニット30の間、前面側 プリント配線板ユニット22と背面側プリント配線板ユ ニット30との間は、バックパネル21内の配線パター ンによって電気的に接続されている。

【0004】プリント配線板実装構造20は、複数の前 面側プリント配線板ユニット22の間、複数の背面側プ リント配線板ユニット30の間、前面側プリント配線板 ユニット22と背面側プリント配線板ユニット30との 間で、LSI24、32のドライバが命令を送り出し、 LSI24、32のレシーバが情報を受け取る動作を行 って情報の処理が行われる。

#### [0005]

[発明が解決しようとする課題] 図1(A). (B)の ブリント配線板実装構造10は、以下の問題を有する。 現在、各プリント配線板ユニット12の処理能力の増加 に伴ってパックパネル11内の配線パターンの数を増や すことが必要となってきている。バックパネル11内の 配線パターンの数を増やすためには、バックパネル11 の層数を増やすこと或いは、図1(B)に符号15で示 20 すようにジャンパ線を追加することが必要となる。パッ クパネル11の層数を増やすと、バックパネル11の製 造コストが相当に高くなってしまう。 ジャンパ線15を 追加した場合には、信頼性が低下してしまう。

[0006] 図2(A), (B) のプリント配線板実装 構造20は、以下の問題を有する。図3に示すように、 前面側プリント配線板ユニット22-1と、前面側プリ ント配線板ユニット22-2と背面側プリント配線板ユ ニット30-1との間での命令の送り出し及び情報の受 け取りについて考えてみる。前面側プリント配線板ユニ ット22-1のLSI24-1からの命令は、符号40 で示すバックパネル21内を通った経路を通って前面側 プリント配線板ユニット22-2のLSI24-2に到 り、LSI24-2からの情報は、上記の経路40を通 ってLSI24-1に到る。また、LSI24-1から の命令は、符号41で示すバックパネル21内を通った 経路を通って背面側プリント配線板ユニット31-1の LSI32-1に到り、LSI32-1からの情報は、 上記の経路41を通ってLSI24-1に到る。上記の 経路40、41の長さは長い。

[0007]上記の経路40、41の長さが長いこと が、情報の処理の高速度化を図る上で障害となってい た。そとで、本発明は上記課題を解決したプリント配線 板実装構造を提供することを目的とする。

#### [8000]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、前面 に前面側コネクタを有し背面に背面側コネクタを有する バックパネルに対して、複数の前面側プリント配線板が その端部のコネクタを上記前面側コネクタと接続させて

**端部のコネクタを上記背面側コネクタと接続させて実装** してある構成のプリント配線板実装構造において、前面 側から見て、該前面側コネクタと該背面側コネクタとは 直交する関係にあり、該前面側プリント配線板と該背面 **側ブリント配線板とが直交する関係にある構成としたも** のである。

【0009】背面側プリント配線板がバックパネルの一 部として機能する構成と出来、このようにした場合に は、バックパネルの層数を少なくしてバックパネルの負 担を軽くすることが出来、よって、製造コストを抑える **とが出来る。また、ジャンパ線の追加配線を無用とし** 得、よって、信頼性の向上を図ることが出来る。また、 背面側ブリント配線板に信号処理索子を実装した構成と した場合には、信号は専ら背面側プリント配線板上で信 号処理素子間を伝送されれば足り、バックパネルを通し て伝送されていた従来に比べて、信号伝送経路が短縮さ れ、信号処理を従来に比べて高速化出来る。

【0010】請求項2の発明は、請求項1の発明におい て、上記バックパネルは、前面側に突き出た複数の前面 側ピンと背面側に突き出た複数の背面側ピンとを有し、 該背面側ピンは上記前面側ピンの一部のピンと電気的に 接続してあり、該背面側ピンとてれらと電気的に接続さ れて前面側に突き出た前面側ピンとが共通ピンを構成し ており、上記背面側コネクタは、上記共通ピンのみを有 する構造であり、 上記前面側コネクタは、上記共通ビ ンを含んで上記前面側ピンを有する構造であるようにし たものである。

[0011]背面側コネクタが共通ピンのみを有する構 造であるため、背面側ブリント配線板によって、別々の 前面側ブリント配線板同士間を効率良く電気的に接続す るととが可能となる。請求項3の発明は、請求項2の発 明において、上記前面側ピン、背面側ピン及び共通ピン は、上記バックパネルのスルーホールを貫通しているブ レスフィットピンである構成としたものである。

【0012】プレスフィットピンをスルーホールを貫通 させれば足りるため、共通ピンを簡単に構成可能であ る。請求項4の発明は、請求項2の発明において、上記 前面側ピンは、上記バックパネルのスルーホールを貫通 孔に、該バックパネルの前面側から該バックパネルの厚 さの約半分に相当する長さ圧入されている構造であり、 上記共通ピンは、上記バックパネルのスルーホールの同 じ貫通孔に、該バックパネルの前面側から該バックパネ ルの厚さの約半分に相当する長さ圧入されているピン と、該バックパネルの背面側から該バックパネルの厚さ の約半分に相当する長さ圧入されているピンとよりなる 構成としたものである。

【0013】圧入が浅くて足りるため、ピン曲がりが発 生しにくい構造を実現出来る。請求項4の発明は、請求 項2の発明において、上記前面側ピンは、上記バックパ 実装してあり、且つ複数の背面側プリント配線板がその 50 ネルの前面のバッドに半田付けされて固定してあるピン であり、上記背面側ピンは、上記バックパネルの背面のパッドに半田付けされて固定してあるピンであり、上記共通ピンは、上記バックパネル内のピアと、該ピアと電気的に接続されて上記バックパネルの背面のパッドに半田付けされて固定してあるピンと、該ピアと電気的に接続されて上記バックパネルのの前面のパッドに半田付けされて固定してあるピンとよりなる構成としたものである。

【0014】圧入をしないため、ピン曲がりが発生しにくい構造を実現出来る。また、バックパネルにはスルー 10 ホールが無いため、背面のうち前面側ピンに対向する領域に、配線パターンを形成することが可能であり、且つ、この領域に、電子部品を実装することも出来る。請求項6の発明は、請求項1の発明において、上記背面側プリント配線板は、その端部のコネクタ間をつなぐ配線パターンを有する構成としたものである。

[0015] 背面側プリント配線板がバックパネルの一部として機能する構成と出来る。この場合には、バックパネルの層数を少なくしてバックパネルの負担を軽くすることが出来、よって、製造コストを抑えることが出来 20る。また、ジャンパ線の追加配線を無用とし得、よって、信頼性の向上を図ることが出来る。請求項7の発明は、請求項1の発明において、上記背面側プリント配線板は、信号処理を行う複数の素子が実装してあり、互いの素子間をつなぐ配線パターン及び該索子と該背面側プリント配線板の端部のコネクタ間をつなぐ配線パターンとを有する構成としたものである。

[0016]信号は専ら背面側プリント配線板上で信号処理素子間を伝送されれば足り、パックパネルを通して伝送されていた従来に比べて、信号伝送経路が短縮され、信号処理を従来に比べて高速化出来る。請求項8の発明は、請求項1の発明において、上記バックパネルは、前面側から見て、上記前面側コネクタと背面側コネクタとが交差する箇所の近傍の部位に、信号処理を行う素子が実装してある構成としたものである。

【0017】素子が上記の部位に実装されているととによって、前面側プリント配線板から素子を経て背面側プリント配線板に到る信号の伝送経路を効率的に短く出来、よって、信号処理を従来に比べて高速化出来る。請求項9の発明は、請求項7又は請求項8記載のプリント配線板実装構造を備えてなる構成としたものである。

[0018] 信号処理が従来に比べて高速化されたサーバを実現出来る。

[0019]

【発明の実施の形態】 (第1実施例) 図4(A),

(B) は本発明の第1実施例になるブリント配線板実装構造50を示す。図5及び図6は、図4(A)。(B)のプリント配線板実装構造50を分解して示す。ブリント配線板実装構造50は、通常の通信装置のシェルフ(図示せず)内に組み込まれているものである。

【0020】プリント配線板実装構造50は、シェルフ (図示せず)内に固定されてX-Z面内に位置している バックパネル51と、バックパネル51の背面にコネク タ接続されて実装してある複数の背面側プリント配線板 52と、前側からシェルフ(図示せず)内に挿入されて バックパネル51とコネクタ接続されて実装してある複 数の前面側プリント配線板ユニット53とよりなる。背 面側プリント配線板52はX-Y面である水平面内に位 置する姿勢で、Z1-Z2方向に複数並んでおり、バッ クパネル51自体でまかなうことができるX1-X2方 向の配線パターンの数を越える配線パターンをまかなう 役割を有する。前面側プリント配線板ユニット53は、 Y-Z面である垂直面内に位置する姿勢で、X1-X2 方向に並んでおり、バックパネル51自体でまかなうこ とができる21-22方向の配線パターンの数を越える 配線パターンをまかなう役割を有する。

【0021】ブリント配線板実装構造50をその前側か ら見たときに、前面側プリント配線板ユニット53は垂 直、背面側プリント配線板52は水平であり、前面側プ リント配線板ユニット53と背面側プリント配線板52 とは直交する関係にある。バックパネル51は、複数層 の配線構造を有するものであり、X1, X2方向に延在 する多数の配線パターン70及び21.22方向に延在 する多数の配線パターン70aを有する。配線層の数 は、バックパネル51を通常の歩留りで且つ通常の製造 コストで製造できる値である。バックパネル51自体で まかなえる配線パターンの数を越える配線パターンにつ いては、背面側プリント配線板52及び前面側プリント 配線板ユニット53がこれをまかなう構成である。よっ 30 て、バックパネル51は、背面側に背面側プリント配線 板52がコネクタ接続されて実装され、前面側に前面側 ブリント配線板ユニット53がコネクタ接続されて実装 される構成となっている。

【0022】 ここで、バックパネル51に設けてあるコ ネクタについて説明する。図7及び図8を併せ参照して 示すように、パックパネル51には、前面51aに前面 側コネクタ54が整列して設けてあり、背面51bに背 面側コネクタ55が整列して設けてある。 バックパネル 51には、多数のプレスフィットピン56がスルーホー 40 ル57内に圧入されてプレスフィットされており、バッ クパネル51を貫通しており、後述するコネクタ54に 対応した配置で並んでいる。 プレスフィットピン56の うち、符号56Aで示すプレスフィットピンはコネクタ 54の一部を構成し、符号56Bで示すプレスフィット ピンはコネクタ54とコネクタ55とに共通に利用され てコネクタ54の一部とコネクタ55の一部とを構成す る。よって、プレスフィットピン56Bを共通プレスフ ィットピンという。プレスフィットピン56Aは、バッ クパネル51の前面51aに突き出ているピン部56A 50 aと、バックパネル51の背面51bに突き出ているピ

ン部56Abとを有する。共通プレスフィットピン56 Bは、バックパネル51の前面51aに突き出ているピ ン部56日aと、バックパネル51の背面51bに突き 出ているピン部56Bbとを有する。プレスフィットピ ン56Aは、スルーホール57内でバックパネル51内 の配線パターン70又は配線パターン70aと電気的に 接続してある。共通プレスフィットピン56Bがプレス フィットされるスルーホールはバックパネル5 1 内の配 線パターン70、70aとは電気的に接続されていず、 共通プレスフィットピン56Bはバックパネル51内の 10 配線パターン70、70aとは電気的に接続されていな 63.

【0023】コネクタ54は、ピン部56Aa及びピン 部56日aと、コネクタガイド58とよりなる。コネク タガイド58は、底板の多数の孔をピン部56Aa、5 6Baと嵌合させて、押さえバー59によってバックパ ネル51の前面51aに固定してある。コネクタガイド 58内にピン部56Aa、56Baが突き出ている。コ ネクタ54は、長手方向が21、22方向である向きで ある。

【0024】コネクタ55は、ピン部56Bbと、コネ クタガイド60とよりなる。コネクタガイド60は、底 板の多数の孔をピン部56Bbと嵌合させて、押さえバ ーによってバックパネル51の背面51bに固定してあ る。コネクタガイド57内にピン部56Bbが突き出て いる。コネクタ54は、長手方向がX1, X2方向であ る向きであり、図7に示すように、X1,X2方向上隣 合う2つのコネクタ54間に跨がっている。

【0025】また、図9に示すように、所定のコネクタ 54については1つのコネクタ54に対応して2つのコ 30 パターン70を有し、配線パターン70aは有してい ネクタ55が設けてある。図4、図5及び図6に示すよ うに、背面側プリント配線板52は、X1, X2方向に 延在する複数の配線パターン71を有する。配線パター ン71は、背面側プリント配線板52の端部に沿って設 けてある複数のコネクタ62の間をつないでいる。背面 側プリント配線板52は、コネクタ62をコネクタ55 に接続してバックパネル51の背面51bに実装してあ る。

【0026】X1, X2方向上離れて位置しているコネ クタ54のプレスフィットピン56Aの間は、バックパ 40 ネル51の配線パターン70でもって電気的に接続して ある。X1、X2方向上離れて位置しているコネクタ5 4のプレスフィットピン56Bの間は、背面側プリント 配線板52の配線パターン71によって電気的に接続し てある。

【0027】前面側プリント配線板ユニット53は、Z 1, 22方向に延在する複数の配線パターン71 aを有 し、且つプリント配線板上にLSI73等が実装してあ り、挿入方向上先頭側にコネクタ63を有する構成であ

3をコネクタ54と接続されて実装してある。別々の前 面側プリント配線板ユニット53の間は、バックパネル 51の配線パターン70及び背面側プリント配線板52 の配線パターン71によって電気的に接続されている。 【0028】別々の背面側プリント配線板52の間は、 バックパネル51の配線パターン70a及び前面側ブリ ント配線板ユニット53の配線パターン71aによって 電気的に接続されている。上記の構成のブリント配線板 実装構造50は、以下の効果を有する。

● 背面側プリント配線板52及び前面側プリント配線 板ユニット53がバックパネル51の機能を果たすた め、バックパネル51は配線層の数がバックパネル51 を通常の歩留りで且つ通常の製造コストで製造できる値 に留めることが出来、よって、プリント配線板実装構造 50全体の製造コストが安価に出来る。

【0029】② 背面側ブリント配線板52は、配線バ ターン71を有し、且つ、バックパネル51の背面にコ ネクタ接続されて実装してあり、且つ、前面側プリント 配線板ユニット53は、配線パターン71aを有し、且 つ、バックパネル51の前面にコネクタ接続されて実装 してあるため、ジャンバ線を使用する構成に比べて信頼 性の向上を図ることが出来る。

【0030】 ことで、上記実施例の変形例について説明 する。以下の第1、第2の変形例がある。第1の変形例 は、バックパネル51は配線パターン70及び配線パタ ーン70aを有し、背面側プリント配線板52は配線パ ターン71を有し、前面側プリント配線板ユニット53 は配線パターン71aを有しない構成である。

【0031】第2の変形例は、バックパネル51は配線 ず、背面側プリント配線板52は配線パターン71を有 し、前面側プリント配線板ユニット53は配線パターン 71aを有しない構成である。次に、バックパネル51 上のコネクタ54、55の変形例について説明する。図 10は第1の変形例を示す。コネクタ54Aは、図8中 のバックパネル51を貫通するプレスフィットピン56 に代えて、バックパネル51のスルーホール57内にバ ックパネル51の前面51a側からバックパネル51の 厚さ t の約 1/2の深さまで圧入されたピン80を有す る構成である。コネクタ55Aは、図8中のバックパネ ル51を貫通するプレスフィットピン56に代えて、バ ックパネル51のスルーホール57内にバックパネル5 1の背面51b側からバックパネル51の厚さtの約1 /2の深さまで圧入されたピン81を有する構成であ る。ピン81と、ピン80のうちピン81と整列してし ているピン80Aとは、スルーホール57を通して導通 している。

【0032】ピン81とピン80Aとが共通ピンを構成 する。このコネクタ54A、55Aは、ピン80、81 る。前面側プリント配線板ユニット53は、コネクタ650水スルーホール57を貫通していずスルーホール57の

途中の位置までの圧入に留まっているため、圧入すると きにピン80、81に曲がりが起きにくい。よって、コ ネクタ54A、55Aは、ピン曲がりが少ないものとな り、背面側プリント配線板52とコネクタ55Aとの接 続及び前面側プリント配線板ユニット53とコネクタ5 4Aとの接続がより信頼性高くなされ、よって、プリン ト配線板実装構造がより信頼性高く組立てられる。

9

【0033】図11は第2の変形例を示す。コネクタ5 4日は、図8中のバックパネル51を貫通するプレスフ ィットピン56に代えて、バックパネル51Bの前面5 10 1 B a 上のバッド90 に半田付けされて固定してあるビ ン91を有する構成である。コネクタ55Bは、図8中 のバックパネル51を貫通するプレスフィットピン56 に代えて、バックパネル51Bの背面51Bb上のパッ ド92に半田付けされて固定してあるピン93を有する 構成である。ピン93と、ピン91のうちピン93に対 応するピン91Aとの間は、バックパネル51B内のビ ア94によって電気的に接続してある。

【0034】ピン93とピン91Aとが共通ピンを構成 する。コネクタ54日、55日は、ピン91、93を圧 20 入していないため、ピン91、93に曲がりがない。ま た、バックパネル51Bはスルーホールを有していない ため、図11に示すように、バックパネル51Bの背面 51Bbのうちコネクタ54Bに対応する部分に、配線 パターン95を形成して電子部品96を実装することも 出来る。

【0035】[第2実施例]図12(A), (B)及び 図13は本発明の第2実施例になるプリント配線板実装 構造100を示す。図14及び図15は、図12

して示す。プリント配線板実装構造100は、図16に 示すサーバ110の筐体111内に強制空冷用ファン等 と共に組み込まれているものであり、情報の処理を行 う。

【0036】プリント配線板実装構造100は、サーバ 110の筐体111内に固定されてX-Z面内に位置し ているバックパネル101と、バックパネル101の背 面にコネクタ接続されて実装してある複数の背面側ブリ ント配線板ユニット102と、サーバ110の前側から 筐体111内に内に挿入されてバックパネル101とコ 40 ネクタ接続されて実装してある複数の前面側プリント配 **線板ユニット103とよりなる。背面側プリント配線板** ユニット102はX-Y面である水平面内に位置する姿 勢で、21-22方向に複数並んでいる。前面側プリン ト配線板ユニット103は、Y-Z面である垂直面内に 位置する姿勢で、X1-X2方向に並んでいる。プリン ト配線板実装構造100をその前側から見たときに、前 面側プリント配線板ユニット103は垂直、背面側プリ ント配線板ユニット102は水平であり、前面側プリン

ト102とは直交する関係にある。

【0037】図17に示すように、バックパネル101 は、複数層の配線構造を有する。バックパネル101に は、前面101aに前面側コネクタ104が整列して設 けてあり、背面101 bに背面側コネクタ105が整列 して設けてある。コネクタ104は、バックパネル10 1の略全高さに亘る Z1, Z2方向に長いものであり、 X1-X2方向に並んでいる。コネクタ105は、バッ クパネル101の略全幅に亘るX1, X2方向に長いも のであり、 Z1-Z2方向に並んでいる。 コネクタ10 4, 105は、図8と同様に多数のプレスフィットピン を有する構成である。コネクタ104とコネクタ105 とが交差している部分のプレスフィットピンが共通プレ スフィットピンである。

【0038】図12乃至図15に示すように、背面側ブ リント配線板ユニット102は、コネクタ106をコネ クタ105に接続してバックパネル101の背面101 bに実装してある。前面側プリント配線板ユニット10 3は、コネクタ107をコネクタ104に接続してバッ クパネル101の前面101aに実装してある。図13 に示すように、背面側プリント配線板ユニット102に は、各前面側プリント配線板ユニット103-1~10 3-6に対応する複数のLSI108-1~108-6 が実装してある。各LSI108-1~108-6は、 ドライバとレシーバとを備えており、情報の処理を行 う。背面側プリント配線板ユニット102には、各LS I108-1~108-6と対応する前面側プリント配 線板ユニット103-1~103-6(共通プレスフィ ットピン)とを電気的に接続する配線パターン109 (A), (B)のプリント配線板実装構造100を分解 30 と、各LSI108-1~108-6間を電気的に接続 する配線パターン110とが設けてある。

> 【0039】ととで、図13中、離れている前面側プリ ント配線板ユニット103-1と前面側プリント配線板 ユニット103-6との間での命令の送り出し及び情報 の受け取りについて考えてみる。LSI108-1は前 面側プリント配線板ユニット103-1に対応するもの であり、LSI108-6は前面側プリント配線板ユニ ット103-6に対応するものである。前面側プリント 配線板ユニット103-1からの命令は、LSI108 - 1 から出て、配線パターン 1 1 0 を通って L S I 1 0 8-6に到り、前面側プリント配線板ユニット103-6からの情報はLSI108-6から出て、配線パター ン110を通ってLSI108-1に到る。上記のよう に、命令及び情報は、専ら背面側ブリント配線板ユニッ ト102内で伝送され、バックパネル101を経由しな い。よって、命令及び情報の伝達経路が短く、情報の処 理が従来に比べてより高速度で行われる。

【0040】また、プリント配線板実装構造100は、 図13中二点鎖線で示すように背面側プリント配線板ユ ト配線板ユニット103と背面側プリント配線板ユニッ 50 ニット102を利用して別のプリント配線板実装構造と

11

接続させることが可能であり、拡張性を有ずる。

〔第3実施例〕第3実施例及び第4実施例は、上記の第 2 実施例の変形例的なものである。

【0041】図18は本発明の第3実施例になるプリン ト配線板実装構造100Aを示す。プリント配線板実装 構造100Aは、バックパネル101Aと、複数の背面 側プリント配線板ユニット102Aと、複数の前面側プ リント配線板ユニット103Aとよりなる。プリント配 線板実装構造100Aをその前側から見たときに、前面 側プリント配線板ユニット103Aと背面側プリント配 10 線板ユニット102Aとは直交する関係にある。

【0042】図19に併せて示すように、バックパネル 101Aには、ドライバとレシーパとを備えており情報 の処理を行うLSI108Aが、前面101Aaのう ち、前面から見てコネクタ104とコネクタ105とが 交差している箇所の4つのコーナ部115に1つづつ実 装してある。図19中、矢印120、121は、信号の 流れの1例を示す。信号は、前面側プリント配線板ユニ ット103Aから出た信号は、コネクタ104及びバッ クパネル101A内の配線パターンを矢印120で示す 20 ように経て、LSI108Aに到る。LSI108Aで 処理された信号は、バックパネル101A内の配線パタ ーンを矢印121で示すように経てコネクタ105に到 り、コネクタ105を経て背面側プリント配線板ユニッ ト102Aに到る。このように、信号の伝送経路が短

【0043】図20は本発明の第4実施例になるブリン ト配線板実装構造100Bを示す。ブリント配線板実装 構造100Bは、バックパネル101Bと、複数の背面 側プリント配線板ユニット102Bと、複数の前面側プ 30 リント配線板ユニット103Bとよりなる。プリント配 **線板実装構造100Bをその前側から見たときに、前面** 側プリント配線板ユニット103Bと背面側プリント配 線板ユニット102Bとは直交する関係にある。

【0044】図21に併せて示すように、バックパネル 101Bには、ドライバとレシーバとを備えており情報 の処理を行うLSI108B1及び108B2が、前面 101Aaに実装してある。LSI108B1は、前面 から見てコネクタ104とコネクタ105とが交差して いる箇所のコーナ部125に実装してある。 LSI10 40 8B2は、LSI108B1よりひと回り大きいサイズ であり、コネクタ104とコネクタ105とによって囲 まれる部分126に実装してある。

【0045】図21中、矢印127はLSI108B1 に関する信号の流れを示し、矢印128はLSI108 B2に関する信号の流れを示す。信号の伝送経路は短

[変形例] 図22はバックパネル101Cを示す。この バックパネル101Cは、図19のバックパネル101

代えて、複数のコネクタ130が21, 22方向に直線 状に整列している。図19中のコネクタ105代えて、 複数のコネクタ131がX1, X2方向に直線状に整列 している。バックパネル101Cの正面から見て、コネ クタ130とコネクタ131は交差している。

【0046】図23はバックパネル101Dを示す。と のパックパネル101Dは、図22のバックパネル10 1 Cとは、各コネクタ131が隣合うコネクタ130の 間に位置しており、バックパネル101Cの正面から見 て、コネクタ130とコネクタ131が交差していない 点が相違する。このバックパネル101Dは共通ピンを 有しない。

【0047】なお、図23のバックパネル101Dにお いて、コネクタ130とコネクタ131との間をバック パネル101D内の配線パターンで接続してもよい。 C の場合に、LSI108Dを設けていない構成でもよ

#### [0048]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1の発明に よれば、前面に前面側コネクタを有し背面に背面側コネ クタを有するバックパネルに対して、複数の前面側ブリ ント配線板がその端部のコネクタを上記前面側コネクタ と接続させて実装してあり、且つ複数の背面側プリント 配線板がその端部のコネクタを上記背面側コネクタと接 続させて実装してある構成のブリント配線板実装構造に おいて、前面側から見て、該前面側コネクタと該背面側 コネクタとは直交する関係にあり、該前面側プリント配 線板と該背面側プリント配線板とが直交する関係にある 構成としたため、背面側プリント配線板がバックパネル の一部として機能する構成と出来る。この場合には、バ ックパネルの層数を少なくしてバックパネルの負担を軽 くすることが出来、よって、製造コストを抑えることが 出来る。また、ジャンパ線の追加配線を無用とし得、よ って、信頼性の向上を図ることが出来る。また、背面側 プリント配線板に信号処理素子を実装した構成と出来 る。この場合には、信号は専ら背面側プリント配線板上 で信号処理索子間を伝送されれば足り、バックパネルを 通して伝送されていた従来に比べて、信号伝送経路が短 縮され、信号処理を従来に比べて高速化出来る。

【0049】請求項2の発明によれば、上記バックパネ ルは、前面側に突き出た複数の前面側ピンと背面側に突 き出た複数の背面側ピンとを有し、該背面側ピンは上記 前面側ピンの一部のピンと電気的に接続してあり、該背 面側ピンとこれらと電気的に接続されて前面側に突き出 た前面側ピンとが共通ピンを構成しており、上記背面側 コネクタは、上記共通ピンのみを有する構造であり、上 記前面側コネクタは、上記共通ビンを含んで上記前面側 ピンを有する構造であり、背面側コネクタが共通ピンの みを有する構造であるため、背面側プリント配線板によ Aの変形例的なものである。図19中のコネクタ104 50 って、別々の前面側プリント配線板同士間を効率良く電

気的に接続することが出来る。

【0050】請求項3の発明によれば、上記前面側ビン、背面側ビン及び共通ビンは、上記バックバネルのスルーホールを貫通しているプレスフィットビンである構成であるため、共通ビンを簡単に構成出来る。請求項4の発明によれば、上記前面側ビンは、上記バックバネルのえルーホールを貫通孔に、該バックバネルの前面側から該バックパネルの厚きの約半分に相当する長さ圧入されている構造であり、上記共通ビンは、上記バックバネルのスルーホールの同じ貫通孔に、該バックバネルの前面側から該バックパネルの厚さの約半分に相当する長さ圧入されているビンと、該バックバネルの背面側から該バックパネルの厚さの約半分に相当する長さ圧入されているビンとよりなる構成としたため、ビンの圧入深さが浅く、よってビン曲がりが発生しにくい構造を実現出来る。

13

【0051】請求項5の発明によれば、上記前面倒ビンは、上記バックパネルの前面のパッドに半田付けされて固定してあるビンであり、上記背面側ビンは、上記バックパネルの背面のパッドに半田付けされて固定してある 20 ビンであり、上記共通ビンは、上記バックパネル内のビアと、該ビアと電気的に接続されて上記バックパネルの背面のパッドに半田付けされて固定してあるビンと、該ビアと電気的に接続されて上記バックパネルのの前面のパッドに半田付けされて固定してあるビンとよりなる構成としたため、ビン曲がりが発生しにくい構造を実現出来る。また、バックパネルにはスルーホールが無いため、背面のうち前面側ビンに対向する領域に、配線パターンを形成することが可能であり、且つ、この領域に、電子部品を実装することも出来る。 30

【0052】請求項6の発明によれば、上記背面側プリント配線板は、その端部のコネクタ間をつなぐ配線バターンを有する構成としたため、背面側プリント配線板がバックパネルの一部として機能する構成と出来る。この場合には、バックパネルの層数を少なくしてバックパネルの負担を軽くすることが出来、よって、製造コストを抑えることが出来る。また、ジャンパ線の追加配線を無用とし得、よって、信頼性の向上を図ることが出来る。【0053】請求項7の発明によれば、上記背面側プリ

【0053】請求項7の発明によれば、上記背面側ブリント配線板は、信号処理を行う複数の素子が実装してあ 40 り、互いの素子間をつなぐ配線パターン及び該索子と該背面側ブリント配線板の端部のコネクタ間をつなぐ配線パターンとを有する構成としたため、信号は専ら背面側ブリント配線板上で信号処理素子間を伝送されれば足り、バックパネルを通して伝送されていた従来に比べ

て、信号伝送経路が短縮され、信号処理を従来に比べて高速化出来る。

【0054】請求項8の発明によれば、上記バックバネルは、前面側から見て、上記前面側コネクタと背面側コネクタとが交差する箇所の近傍の部位に、信号処理を行 50

う累子が実装してある構成としたため、前面側ブリント 配線板から索子を経て背面側プリント配線板に到る信号 の伝送経路を効率的に短く出来、よって、信号処理を従 来に比べて高速化出来る。

【0055】請求項9の発明は、請求項7又は請求項8 記載のプリント配線板実装構造を備えてなる構成とした ものであるため、信号処理が従来に比べて高速化された サーバを実現出来る。

【図面の簡単な説明】

0 【図1】従来の1例のプリント配線板実装構造を示す図である。

【図2】従来の別の例のブリント配線板実装構造を示す 図である。

[図3]図2のプリント配線板実装構造の問題点を説明 する図である。

【図4】本発明の第1実施例になるブリント配線板実装 構造を示す図である。

【図5】図4(A)のプリント配線板実装構造の分解斜 視図である。

20 【図6】図4(B)のプリント配線板実装構造の分解斜 視図である。

【図7】図5のバックパネルの正面図である。

【図8】図7中、VIII-VIII 線に沿う拡大断面図である。

【図9】図7中、IX-IX 線に沿う拡大断面図である。

【図10】バックパネル上のコネクタの第1の変形例を示す図である。

【図11】バックパネル上のコネクタの第2の変形例を示す図である。

30 【図12】本発明の第2実施例になるプリント配線板実 装構造を示す図である。

【図13】図12のプリント配線板実装構造の平面図である。

【図14】図12(A)のプリント配線板実装構造の分解斜視図である。

【図15】図12(B)のプリント配線板実装構造の分解斜視図である。

【図16】サーバを示す斜視図である。

【図17】図14のバックパネルの正面図である。

0 【図18】本発明の第3実施例になるプリント配線板実 装構造の一部切截斜視図である。

【図19】図18のバックパネルの正面図である。

【図20】本発明の第4実施例になるプリント配線板実 装構造の一部切截斜視図である。

【図21】図20のバックパネルの正面図である。

【図22】バックパネルの第1の変形例を示す正面図で ある。

【図23】バックパネルの第2の変形例を示す正面図で ある。

50 【符号の説明】

15

16 \*56B 共通プレスフィットピン

50, 100, 100A, 100B プリント配線板実装構造

51、101、101A~101C バックパネル

52、102 背面側プリント配線板

53、103 前面側ブリント配線板ユニット

54、104 前面側コネクタ

55、105 背面側コネクタ

56、56A プレスフィットピン

57 貫通孔

58、60 コネクタガイド

62、63、106、107 コネクタ

70,71 配線パターン

80、81 ピン

108 LSI

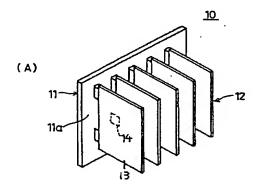
[図1]

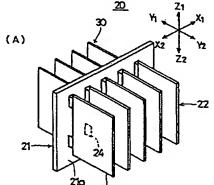
【図2】

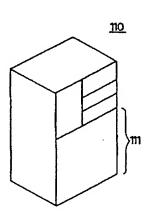
[図16]

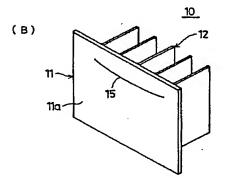
# 従来の1例のブリント配貌被実被構造を示す団 従来の別の例のブリント記載技実技能性を示す団

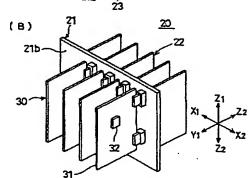
サーバを示す図





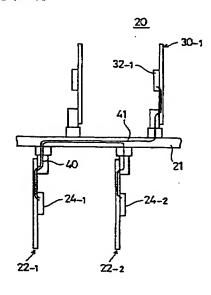






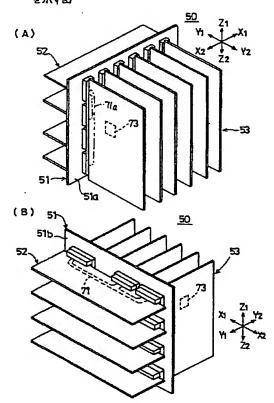
[図3]

図2のプリント配線灰実技構造の問題点を 受明する図



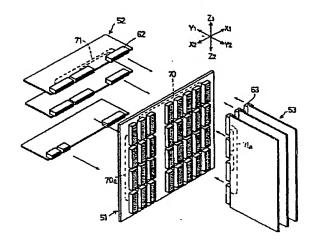
[図4]

本元明の第1実施例になるプリント政党政党芸術造 を示す回



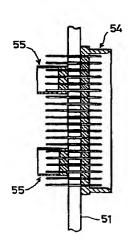
【図5】

図4(A)のプリンを教授大芸術をの分析納視図



[図9]

図1中. IX-IX 续に分う拡大断面図

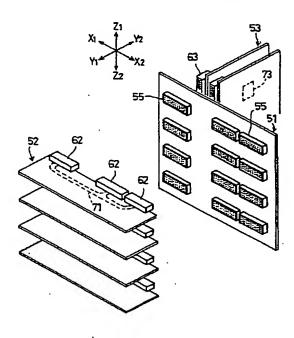


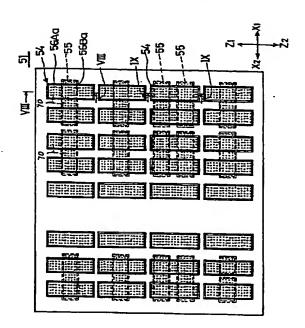
【図6】

図4(B)のプリント配算支表構造の分解斜視図



### 図5のバックパネルの王面図



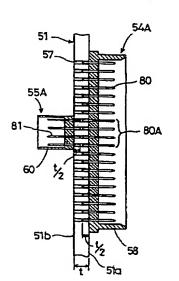


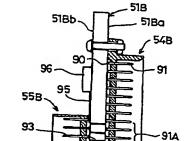
[図10]

【図11】

バックパネル上のコキクタの第2の変形例を示す図

# バークベネル上のコネクタの夢7の変形例を示す団



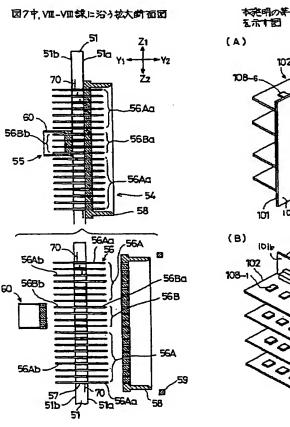


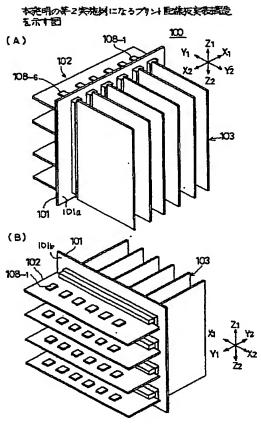
60

9ź

[図8]

【図12】





[図13]

図12のブリンを終灰実技構造の平面図

【図14】

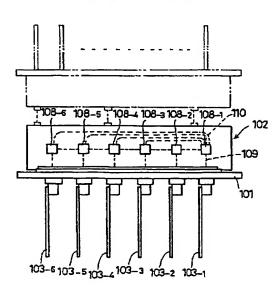
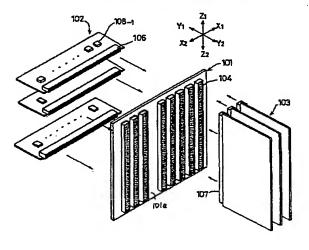
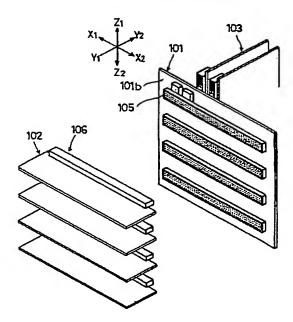


図12(A)のプリントに発表を表演造の分容点を図



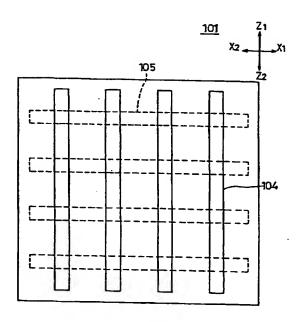
【図15】

# 図12(8)のブリン正律探史表質点の介許斜視図



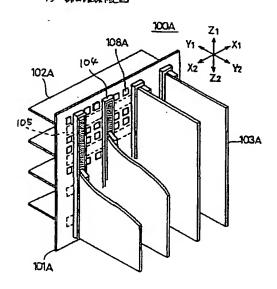
[図17]

### 図14のバックパネルの正面図



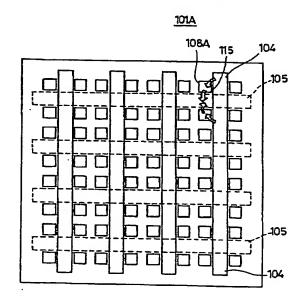
【図18】

# 本発明の第3 実施例のプリン配線板実装構造の一部の複製視図



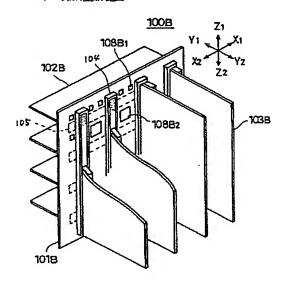
【図19】

# 図18中のバックバネルの正面図



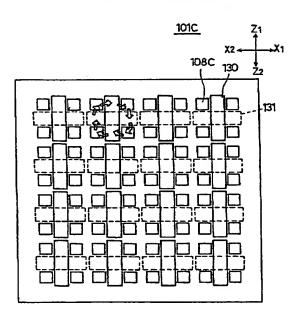
[図20]

### 本発明の第4実施例のブリン配案板実装構造 の一部が厳料視団



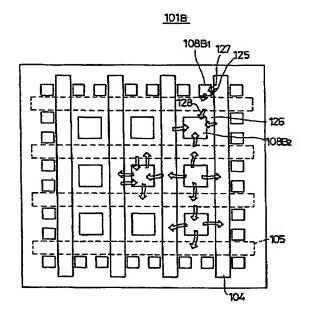
[図22]

# バックバネルの等1の実形例を示す正面図



【図21】

#### 図20中のバックバネルの正面図



[図23]

### バークパネルの第2の支形例を示す正面図

